

ひとわざ(一技)名: 微小スポットで高密度、精密部品の半田付や溶着

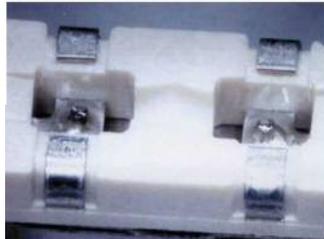
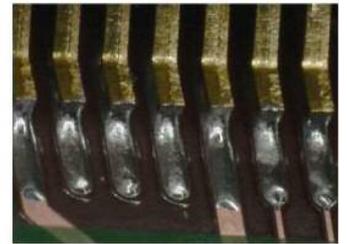
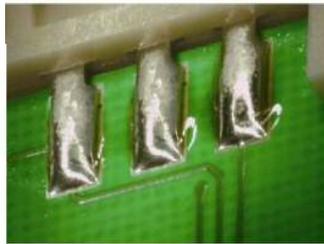
1. 概要(200字目安)

1. 微小レーザースポット径100 μ m、光学レンズにより、50 μ mスポットも実現可能です。
2. 半田付け部のみを局所加熱することにより、部品へのダメージを低減できます。
3. 高密度、高精度となっている、スマートフォンやモバイル機器の部品やパターンの半田付けに最適です。

写真・図(要点説明)



ファイバ出力型レーザーシステム
FOM SYSTEM



精密部品の半田付け例

2. 企業概況

| | | | | |
|----------|--------------------------------|--------|--|---|
| 会社名 | 株式会社堀内電機製作所 | | 代表者名 | 代表取締役社長 長谷川 宣男 |
| | | | 窓口担当 | 宮原 仁 |
| 事業内容 | FA機器開発製造販売 コンピュータ周辺機器製作組み立て | | URL | http://www.horiuchielectronics.co.jp |
| 主要製品 | レーザーマーカ、ロボットシステム等のFA装置 | | | |
| 住所 | 〒386-1321 長野県上田市保野241 | | | |
| 電話/FAX | 0268-38-5265/5198 | E-mail | sales@horiuchielectronics.co.jp | |
| 資本金(百万円) | 30 | 設立年月日 | S28/10/22 | 売上(百万円) 3400 従業員数 280名 |

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③医療分野参入(取引)実績 他

- ① ISO14000所得
- ② 工場: 上田工場、岡谷工場、横浜工場、青梅工場、神田ショールーム
- ③ 電気通信大学と産学連携による共同研究実施中